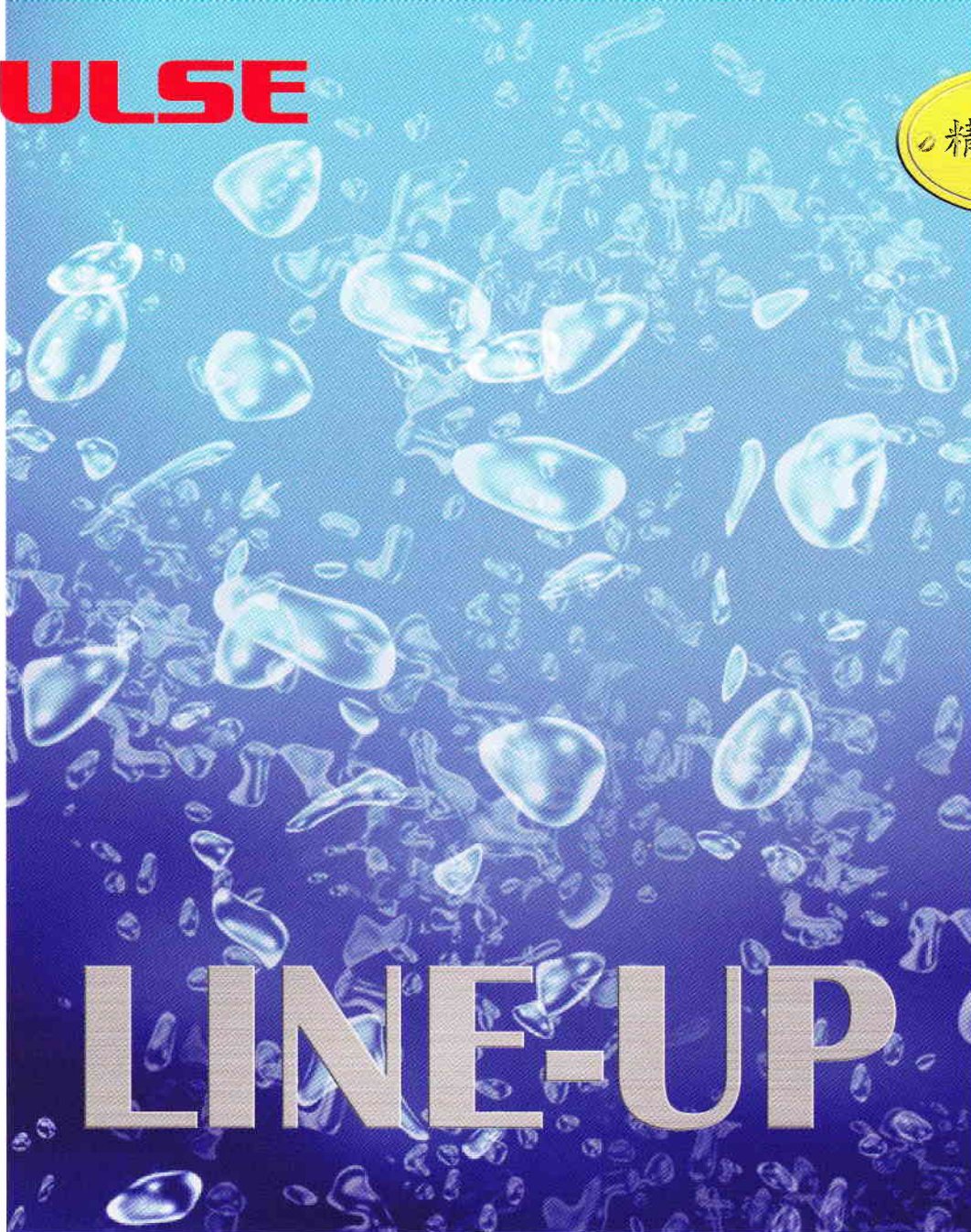


i-PULSE



LINE-UP

アイパルス株式会社

SMT

アイパルス独自の高い汎用性と未来に向けたハイブリッド性を備えた
ハイコストパフォーマンスマニュファクチャリングセンター新登場！

New



パフォーマンス追求のベースマシンに
ハイブリッド機能の将来的拡張性を待たせ
次世代の生産形態に対応

M20



New



M20の汎用性、生産性をそのままに
ハイコストパフォーマンス、省スペース化を実現した
ローコストエントリーマシン

M10



AOI



ハイブリッド(X線+光学)検査装置
X線画像と光学画像を同一視野で
取得可能な先進の検査装置です。



光学式基板外観検査装置
印刷後、マウント後、リフロー後全てに対応する
低価格でフレキシブルな検査装置です。



KX2H K2H K2H-L

New



**ハイコストパフォーマンス
マウンティングセンター**

基板サイズL1200まで搭載可能！
更に対応力がアップして登場。



マルチフレックスプラットフォーム

最長1290×410mmまでの大型基板に対応
マルチビーム方式の高速モデル。



ミニモジュールマウンター

匠の技と最新デジタル技術の融合。
新たにBGA・CSP等のトレイ部品にも対応します。



※写真の台座はオプション仕様

卓上型基板外観検査装置

最新の検査性能をコンパクトボディに
納めたオールインワンマシン。



仕様

M20 M10

	M20	M10
基板寸法 (1ドライブ)	L50 x W30 ~ L1,240 x W510mm	L50 x W30 ~ L740 x W510mm
基板寸法 (2ドライブ)※1	L50 x W30 ~ L640 x W510mm	L50 x W30 ~ L540 (※2) x W510mm
基板寸法 (3ドライブ)※3	L50 x W30 ~ L540 x W510mm	
実装タクト		
(4ヘッド+1θ) 最速条件	0.15sec/CHIP (24,000CPH)	
(4ヘッド+4θ) 最速条件	0.15sec/CHIP (24,000CPH)※1	
(6ヘッド+2θ) 最速条件	0.12sec/CHIP (30,000CPH)※1	
(4ヘッド+1θ) IPC9850	19,000CPH	
(4ヘッド+4θ) IPC9850	19,000CPH※1	
(6ヘッド+2θ) IPC9850	23,000CPH※1	
装着精度 A(μ+3σ)	CHIP ±0.040mm	
装着精度 B(μ+3σ)	IC ±0.025mm	
部品品種数※4	144 品種 36 連 × 4	72 品種 36 連 × 2
実装可能部品	0402 ~ 120×90mm BGA, CSP, コネクタ, 他異形部品	
実装可能部品高さ	最大 30mm※5 (先付最大部品高さは 25mm)	
本体寸法	L1,750 x D1,750 x H1,420mm	L1,250 x D1,750 x H1,420mm
重量	約 1,500 kg	約 1,300 kg

※1 M20, M10 共通オプション ※2 バッファ機能有効時最大 480mm
※3 M20 専用オプション ※4 8mm テープ換算 ※5 基板厚み+部品高さ最大 30mm

Miez MOUNTING CENTER

基板寸法 (LxW)	50 x 50 ~ 460 (MAX.L1,200op) x 410mm
実装タクト A※1	6ヘッド: 0.14sec/CHIP, 0.38sec/TSOP(32pin) 3ヘッド: 0.22sec/CHIP, 0.65sec/TSOP(32pin)
実装タクト B※2	6ヘッド: 0.65sec/QFP(100pin) 3ヘッド: 0.8sec/QFP(100pin)
装着精度 (μ+3σ)	CHIP ±0.05mm QFP ±0.035mm
部品品種数	120 品種 (8mm テープ換算)
実装可能部品	0402(op)~QFP, BGA, CSP, コネクタ, 他異形部品
実装可能部品高さ	20mm (先付最大部品高さ 10.5mm)
本体寸法・重量	L1,755 x D1,480 x H1,470mm 約 1,680 kg

※1 6/3ヘッド別吸着・スキャン部調整条件下
※2 6/3ヘッド連続搭載・固定カメラ調整条件下

M7-3L M7-2L

	M7-3L	M7-2L
基板寸法 (LxW)	50×30mm~330/510/1290×410mm	
実装タクト	0.055sec/CHIP 65,000CPH	0.083sec/CHIP 43,000CPH
IPC 基準 (1608C)	IPC50,000CPH	IPC33,000CPH
装着精度 (μ+3σ)	CHIP ±0.040mm IC ±0.025mm	
部品品種数	164 品種 (8mm テープ換算)	
実装可能部品	0402 ~ □23mmIC	
実装可能部品高さ	15mm (前工程先付け部品高さ 10.5mm)	
本体寸法	L1,990 x D1,695 x H1,450mm	
重量	約 2,300kg	約 2,200kg

M3 PLUS MINI MODULE MOUNTER

基板寸法 (LxW)	50×30 ~ 330×250mm
実装タクト (最速条件下)	0.28 sec/CHIP, IPC11,100CPH(1608C)
装着精度 (μ+3σ)	CHIP ±0.05mm, ±0.037mm / ~ □20mm, QFP ±0.05mm
部品品種数	16 品種 (8mm テープ換算)
実装可能部品	0603 ~ □31mm (※1) SOP, SOJ, QFP, コネクタ, PLCC, CSP, BGA
実装可能部品高さ	15mm
本体寸法、重量	L1,195 x D1,255 x H1,350、約 750kg

※1 ヘッドにより対応可能な部品サイズに制約が発生いたします。

※本カタログに使用の写真は各種オプションが装備された状態です。

仕様

KX2H

基板寸法(L x W)	50×50～460×410mm
基板厚さ、重量	0.4～3.0mm、0.65kg以下(基板外形に切り欠き等がないこと)
搬送方向	左→右(標準)、右→左(受注時選択)
検査項目	欠品、位置ズレ、角度ズレ、誤搭載、極性違い、ハンダフィレット、ブリッジ、BGA内ハンダ量、文字認識
検査時間	0.19sec/画面(光学検査、最適条件下) 0.39sec/画面(X線検査+光学検査、最適条件下)
本体寸法・重量	L1,350×D1,580×H1,470mm 約1,940kg

K2H K2H-L

	K2H	K2H-L
基板寸法(L x W)	50×50～330×250mm	50×50～460×410mm
基板厚さ、重量	0.5～2.0mm、0.65kg以下(基板外形に切り欠き等がないこと)	
搬送方向	左→右(標準)、右→左(受注時選択)	
検査項目	印刷検査: 未ハンダ、印刷ズレ、にじみ、かすれ、ブリッジ 部品検査: 欠品、位置ズレ、角度ズレ、誤搭載、極性違い、ブリッジ、文字認識 チップ浮き(※1)、リード浮き(※1)	
検査時間	0.19sec/画面(最適条件下)	
基板搬送高さ	900±20mm	
本体寸法	L1,000×D961×H1,363mm	L1,206×D1,250×H1,360mm
本体重量	約480kg	約800kg

※1 オプションのレーザー変位計使用時

K5 K5L

	K5	K5L
基板寸法(L x W)	50×30～330×300mm (仕様により285～250mm)	50×50～510×410mm
基板厚さ、重量	0.5～3.0mm、0.65kg以下(基板外形に切り欠き等がないこと)	
検査項目	欠品、位置ズレ、角度ズレ、誤搭載、極性違い、ブリッジ、文字認識 チップ浮き(※1)、リード浮き(※1)	
検査時間(最適条件下)	0.47sec/画面	0.45sec/画面
本体寸法	L575×D825×H561mm	L960×D970×H560mm (…×H1,271mmワゴンを含む)
本体重量	約62kg	約136kg (約243kgワゴンを含む)

※1 オプションのレーザー変位計使用時

DI HIGH SPEED DISPENSER

基板寸法(L x W)	50×50～485×410mm
塗布精度	±0.1mm
塗布タクト	0.12sec/shot(最適条件下)
ヘッド数	1本(オプション2本)
塗布方式	エアバルス式
本体寸法、重量	L1,200×D1,230×H1,344mm 約800kg

SDR

基板寸法(L x W)	50×50～330×250mm
塗布精度	±0.15mm
塗布タクト	0.3sec/shot(最適条件: Y方向2mm移動、塗布時間30ms)
ヘッド数	1ヘッド
塗布方式	エアバルス式
本体寸法、重量	L1,000×D900×H1,300mm 約390kg

※仕様・外觀は改良のため、予告なく変更する事があります。



高効率ディスペンサー

クラックモーションヘッドを持つハイスピードディスペンサー。通常の塗布の他、部品の仮止めやアンダーフィル等にも活躍。高精度な画像処理で塗布品質を確保します。



超小型ロボットディスペンサー

通常の塗布の他、部品の仮止めやアンダーフィル等にも活躍。インラインタイプながら、低価格も大きな魅力です。

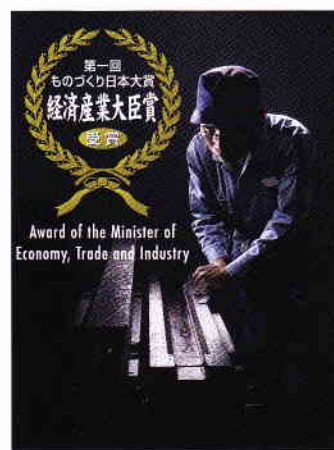


高速・高精度・多機能ハイエンド印刷機

理想的印刷条件を設定可能な3Sヘッドを搭載。大型基板対応(L510×W460mm)鉛フリー対応フルビジョン認識クリームハンダ印刷機です。



- Lサイズ基板対応(L510×W460mm)
- 3Sヘッド
- ライントクト11.0秒
- 位置合わせ精度±5μm
- ユニバーサスマスクサイズ対応
- 印刷検査カメラ
- 自動クリーニングシステム
- CEマーキング対応



アイパルスの「ものづくり」は、少量高品質にこだわっています。生産量を求めない為、量産的な思考ではなく、熟練した巧みの技を持ってより品質の安定した商品に仕上げていきます。最高の精度を永らく……その証にアイパルスのマウンターには総て組み立て責任者のネームプレートを付けています。又、総て自社内での組み立てを行っている為、開発部門や販売部門との連携も円滑で、コスト開発力や特注対応力も強みとなっています。

こだわりの職人集団が一台一台精魂込めて



i-PULSE
アイパルス株式会社
〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-9-3
(都田テクノポリス内) www.ipulse.co.jp
TEL. 053-484-1876 FAX.053-484-1870

※本カタログに使用の写真は各種オプションが装備された状態です。(JAN 2011 ad-Lj11-1-003)